



110 年度工研院 碳材及其應用暨特用化學品(生醫/纖維)專利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人(以下簡稱「國內廠商」)。

三、讓與標的：

本讓與案包含碳材及其應用暨特用化學品(生醫/纖維)專利 20 案 47 件(以下簡稱「讓與標的」)。「讓與標的」相關資訊詳如附件。

四、公開說明會與領標：

1. 公開說明會將於民國（下同）110 年 11 月 26 日 14 時整採線上會議舉辦。
2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 110 年 11 月 25 日 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「碳材及其應用暨特用化學品(生醫/纖維)專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 110 年 11 月 25 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
3. 自本標案公告日起至截標日 110 年 12 月 8 日 17 時整(含)止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

1. 本標案採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同押標金、公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本）、公司基本資料暨運用規劃說明表(以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「碳材及其應用暨特用化學品(生醫/纖維)專利讓與案投標」，於截標日 110 年 12 月 8 日 17 時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至：



310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

工研院技轉法律中心 李小姐 收

2. 本標案採「案」方式投標。「讓與標的」以同一發明為一案。本標案採一案一標，即同一案專利不分開投標/開標。
3. 本標案不得共同投標或重複投標。
4. 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。
5. 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

1. 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
3. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

1. 投標時間截止後之投標。
2. 開標前業已公告停止本標案交易程序。
3. 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
4. 投標單附加任何成交條件者。
5. 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
6. 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標前未能補足者，其投標為無效。

八、決標方法：

1. 開標日為 110 年 12 月 9 日。
2. 開標時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、公司基本資料暨運用規劃說明表進行審查及確認。
3. 同一案以投標廠商出價金額最高且高於底價者得標。同一案有二家（含）以上投標金額相同時，由工研院現場抽籤決之。
4. 開標時將請律師到場監標。
5. 開標後將個別通知投標廠商開標結果（不公告得標廠商）。
6. 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格，但以「國內廠商」且有參與投標者為優先。

九、契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起 20 個工作天內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
2. 得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格，但以「國內廠商」且有參與投標者為優先。
3. 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格，但以「國內廠商」且有參與投標者為優先。
4. 得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、貿易法及戰略性高科技貨品出口管制等規定）。前述法令變動時，亦同。
5. 得標廠商取得「讓與標的」應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
6. 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。
7. 「讓與契約書」經雙方依法簽章報經濟部同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部之意見並無影響能力。
8. 得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與第三人時，並應使該第三人同意本條約定。再為專屬授權或讓與時亦同。
9. 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：（1）工研院已與第三人簽訂之授權契約中關於工研院之義務；（2）工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及（3）工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與他人時，應依政府相關法令規定及「讓與契約書」約定，取得主管機關(包含但不限於經濟部技術處，以下同)核准及/或工研院同意後始得為之，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。
10. 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本標案公告日之「讓與標的」現狀辦理本標案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之尚在申請中

之專利可獲證，或可依原始申請範圍獲證，或已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責，概與工研院無涉；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。

11. 「讓與標的」之讓與登記手續全權由工研院依工研院專利讓與登記作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。
12. 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之法令規定，配合工研院為一切必要之申請，並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提提供工研院。得標廠商且應配合工研院向主管機關及立法院經濟委員會為境外實施等一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及/或主管機關核准及同意後始得為之：
 - (1) 得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；
 - (2) 得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
 - (3) 得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
 - (4) 得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。
13. 得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得解除「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：
 - (1) 得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他

人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。

(2)得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。

(3)為增進國家重大利益者。

得標廠商並同意，若違反「九、契約事項：」之第 4、8、9、12、13、14、15 及 16 項等約定者，工研院得逕行將「讓與標的」非專屬授權予第三人自「讓與契約書」生效日起實施，並保有相關之收益。若有「九、契約事項：」第 13 項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，且經濟部及工研院無須負擔損害賠償責任。

14. 得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與第三人（以下稱「後手」）時，應依政府相關法令及「讓與契約書」約定，取得主管機關及/或工研院同意並將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。
15. 得標廠商應使所有「後手」遵守本條第 8 項至第 10 項、第 12 項至第 17 項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。
16. 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。
17. 得標廠商重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上（以下簡稱「股權變動」）時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」。得標廠商於「股權變動」情事發生後 30 日內，應以書面通知工研院；工研院僅得於該「股權變動」情事導致「讓與契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」或以書面另議新約。
18. 得標廠商應盡力進行產品開發工作，得標廠商未於合理期間內運用「讓與標的」，工研院得以書面解除「讓與契約書」或將「讓與標的」



非專屬授權他人實施，且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院「技轉法律中心」聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本標案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本公告相關問題請洽詢：

工研院「技轉法律中心」 李小姐

電話：(03) 591-7759，傳真：(03) 582-0466

電子信箱：lislee@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室



附件：標的清單

技術分類	案編號	件編號	專利中文名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	非專屬授權紀錄
碳材與纖維	1	024900033JP	適用於低溫熱化學氣相沉積合成奈米碳管的負載金屬觸媒及使用此觸媒的奈米碳管合成方法	JP	獲證	290290/2002	3580549	20040730	20221001	經濟部技術處	
	2	P02930070CN	納米碳纖的制造方法	CN	獲證	200510074314.7	CN100387515	20080514	20250530	經濟部技術處	v
		P02930070TW	奈米碳纖的製造方法	TW	獲證	94117409	I306834	20090301	20250526	經濟部技術處	v
	3	P05920012USD1	氣體感測器及其製造方法	US	獲證	12/846,562	8178157	20120515	20240711	經濟部技術處	
	4	P27020057CN	改質碳材與其形成方法及塗料	CN	獲證	201410647140.8	CN104743539	20170412	20341112	經濟部能源局	
		P27020057TW	改質碳材與其形成方法及塗料	TW	獲證	102149208	I530454	20160421	20331230	經濟部能源局	v
	5	P27990065CZ	奈米碳材承載型觸媒及碳酸酯的製造方法	CZ	獲證	EP11180717.8	2468402	20140528	20310908	經濟部技術處	
		P27990065DE	奈米碳材承載型觸媒及碳酸酯的製造方法	DE	獲證	EP11180717.8	2468402	20140528	20310908	經濟部技術處	
		P27990065FR	奈米碳材承載型觸媒及碳酸酯的製造方法	FR	獲證	EP11180717.8	2468402	20140528	20310908	經濟部技術處	
		P27990065GB	奈米碳材承載型觸媒及碳酸酯的製造方法	GB	獲證	EP11180717.8	2468402	20140528	20310908	經濟部技術處	
		P27990065JP	奈米碳材承載型觸媒及碳酸酯的製造方法	JP	獲證	2011-242432	5840460	20151120	20311103	經濟部技術處	
	6	P54000025CN	納米碳管粉體與其形成方法、複合材料的形成方法	CN	獲證	201110307079.9	CN102993460	20140709	20311007	經濟部技術處	
		P54000025JP	奈米碳管粉體與其形成方法、複合材料之形成方法	JP	獲證	2012-201370	5427281	20131206	20320912	經濟部技術處	
		P54000025TW	奈米碳管粉體與其形成方法、複合材料之形成方法	TW	獲證	100132976	I448422	20140811	20310913	經濟部技術處	
		P54000025US	奈米碳管粉體與其形成方法、複合材料之形成方法	US	獲證	13/349,277	9115271	20150825	20340201	經濟部技術處	
	7	P54000066CN	透明導電膜及其形成方法	CN	獲證	201110461274.7	CN103137238	20150603	20311225	經濟部技術處	
		P54000066KR	透明導電膜與其形成方法	KR	獲證	10-2012-0015338	10-1318195	20131008	20320214	經濟部技術處	



技術分類	案編號	件編號	專利中文名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	非專屬授權紀錄
		P54000066TW	透明導電膜與其形成方法	TW	獲證	100142878	I466140	20141221	20311122	經濟部技術處	
	8	P54010030CN	碳材導電膜的轉印方法	CN	獲證	201210499082.X	CN103786457	20160203	20321128	經濟部技術處	
		P54010030TW	碳材導電膜的轉印方法	TW	獲證	101139868	I524825	20160301	20321028	經濟部技術處	
		P54010030US	碳材導電膜的轉印方法	US	獲證	13/796,048	9067393	20150630	20340219	經濟部技術處	
	9	P54010031TW	導電油墨組成物及透明導電薄膜	TW	獲證	101141731	I525643	20160311	20321108	工研院	
	10	P54010122CN	輻射吸收材料以及輻射屏蔽材料與其形成方法	CN	獲證	PCT/CN2014/201480002648.0	CN104704577	20170613	20340127	經濟部技術處	
		P54010122TW	輻射吸收材料與其製備方法以及輻射屏蔽複合材料與其製備方法	TW	獲證	103103887	I500045	20150911	20340205	經濟部技術處	
	11	P54060020TW	麻花色紋複合紗線	TW	獲證	106218330	M557268	20180321	20271210	工研院	
	12	P54950019TW	碳奈米管分散物及導電薄膜	TW	獲證	95136211	I340732	20110421	20260928	經濟部技術處	
	13	P54950032TW	低溫熱化學氣相沉積反應器	TW	獲證	95140623	I318420	20091211	20261101	經濟部技術處	
	14	P54950037TW	反應性有機改質型無機微粒、其製法及含有此無機微粒之生分解混成材料	TW	獲證	95148162	I332020	20101021	20261220	經濟部技術處	
		P54950037US	反應性有機改質型無機微粒、其製法及含有此無機微粒之生分解混成材料	US	獲證	12/000,860	7846990	20101207	20281014	經濟部技術處	
	15	P54960075CN	耐磨耗的抗靜電纖維及製造方法和製造該纖維的組合物	CN	獲證	200710159781.9	CN101463560	20110720	20271220	工研院	
		P54960075TW	耐磨耗之抗靜電纖維及製造該纖維之組合物及方法	TW	獲證	96147162	I371514	20120901	20271210	工研院	
	16	P54960122TW	官能化奈米碳材的方法	TW	獲證	97127102	I385119	20130211	20280716	經濟部技術處	v
	17	P54970049CN	透明導電膜與其製造方法	CN	獲證	200810170564.4	CN101728007	20130227	20281020	經濟部技術處	
		P54970049KR	透明導電膜與其形成方法	KR	獲證	10-2009-0033448	10-1411974	20140619	20290416	經濟部技術處	
		P54970049TW	透明導電膜與其形成方法	TW	獲證	97130658	I381227	20130101	20280811	經濟部技術處	v



技術分類	案編號	件編號	專利中文名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	非專屬授權紀錄
	18	P54970102CN	奈米無機氧化物的相轉移方法	CN	獲證	200910138434.7	CN101885469	20130731	20290512	經濟部技術處	
		P54970102TW	奈米無機氧化物的相轉移方法	TW	獲證	98113430	I384021	20130201	20290422	經濟部技術處	
		P54970102US	奈米無機氧化物的相轉移方法	US	獲證	12/552,954	8268175	20120918	20300907	經濟部技術處	
	19	P54980078CN	細間距陣列型連接器	CN	獲證	201010004692.9	CN102130083	20120808	20300119	經濟部技術處	
		P54980078TW	細間距陣列型連接器	TW	獲證	98145021	I411074	20131001	20291224	經濟部技術處	
載體技術	20	P13910036CN	生物可分解性共聚合物、及包含此共聚合物之高分子月交束組合物	CN	獲證	03143468.1	CN1272354	20060830	20230929	經濟部技術處	
		P13910036DE	生物可分解性共聚合物、及包含此共聚合物之高分子微胞組合物	DE	獲證	EP3029295.7	EP1550680B1	20060927	20231221	經濟部技術處	
		P13910036FR	生物可分解性共聚合物、及包含此共聚合物之高分子微胞組合物	FR	獲證	EP3029295.7	EP1550680B1	20060927	20231221	經濟部技術處	
		P13910036GB	生物可分解性共聚合物、及包含此共聚合物之高分子微胞組合物	GB	獲證	EP3029295.7	EP1550680B1	20060927	20231221	經濟部技術處	
		P13910036IT	生物可分解性共聚合物、及包含此共聚合物之高分子微胞組合物	IT	獲證	EP3029295.7	EP1550680B1	20060927	20231221	經濟部技術處	
		P13910036TW	生物可分解性共聚合物、及包含此共聚合物之高分子微胞組合物	TW	獲證	92119778	I248947	20060211	20230720	經濟部技術處	
		P13910036US	生物可分解性共聚合物、及包含此共聚合物之高分子微胞組合物	US	獲證	10/745,975	7655258	20100202	20241007	經濟部技術處	